2025年度 大阪公立大学 半導体デバイスプロセス技術基礎講座(会員有料制)

於:大阪公立大学 i-siteなんば および オンライン



主催 大阪公立大学 協創研究センター 半導体超加工・集積化技術研究所

第1回	4月21日	国内・世界の半導体および市場動向と展望(仮)
第2回	5月12日	半導体多層配線プロセス:基礎/材料/プロセス/信頼性(仮)
第3回	6月13日	半導体洗浄・乾燥技術の過去・現在・未来
第4回	6月17日	サーマルマネジメント技術の基礎と現状(仮)
第5回	7月8日	プリント配線板の基礎および最新の応用展開(仮)
第6回	7月24日	CMP技術の基礎と最先端応用(仮)
第7回	8月25日	エピタキシャル成長と最先端CMOS技術(仮)
第8回	9月12日	リソグラフィの基礎と最先端の現状(仮)
第9回	10月6日	CVDとALEの基礎 (仮)
第10回	10月16日	後工程全般 (仮)
第11回	11月11日	プラズマ、エッチングの基礎と各種応用(仮)
【11月12日 (水)】		
第L回	12月3日	光デバイス・光実装(仮)
【12月4日(木)】		
<u>12月11日(木)</u>		
第M回	12月15日	最新の電子デバイス・チップレット (仮)
第N回	1月14日	材料・プロセス業界のための分かりやすいEDA(仮)
第O回	1月21日	最先端CMOS技術(仮)
3月4日	(水) or 3.	<u>月5日(木)</u> 下線の日程(5つ)で、MIについて調整中

和田木 哲哉 氏 モルガンスタンレーMUF.J証券(株) 松永 範昭 氏 アプライドマテリアルズジャパン(株) 服部 毅 氏 **Hattori Consulting International** 西 剛伺 教授 足利大学 工学部 戸田 光昭 氏 (株)メイコー 土肥 俊郎 氏 (株)Doi Laboratory 小椋 厚志 教授 明治大学 理工学部 永原 誠司 氏 ASMLジャパン 霜垣 幸浩 教授 東京大学 高橋 健司 氏 **AIST** 堀 勝 名誉教授 名古屋大学 中野 義昭 教授 豊田工業大学

斉木 一 氏日本AMD松澤 浩彦 氏図研平本 俊郎 教授東京大学

日程、内容は変更されることがございます